

2026年3月期 第1四半期（2025年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2025年7月31日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2026年3月期 第1四半期 連結決算の概要

2025年7月31日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



損益状況（四半期）

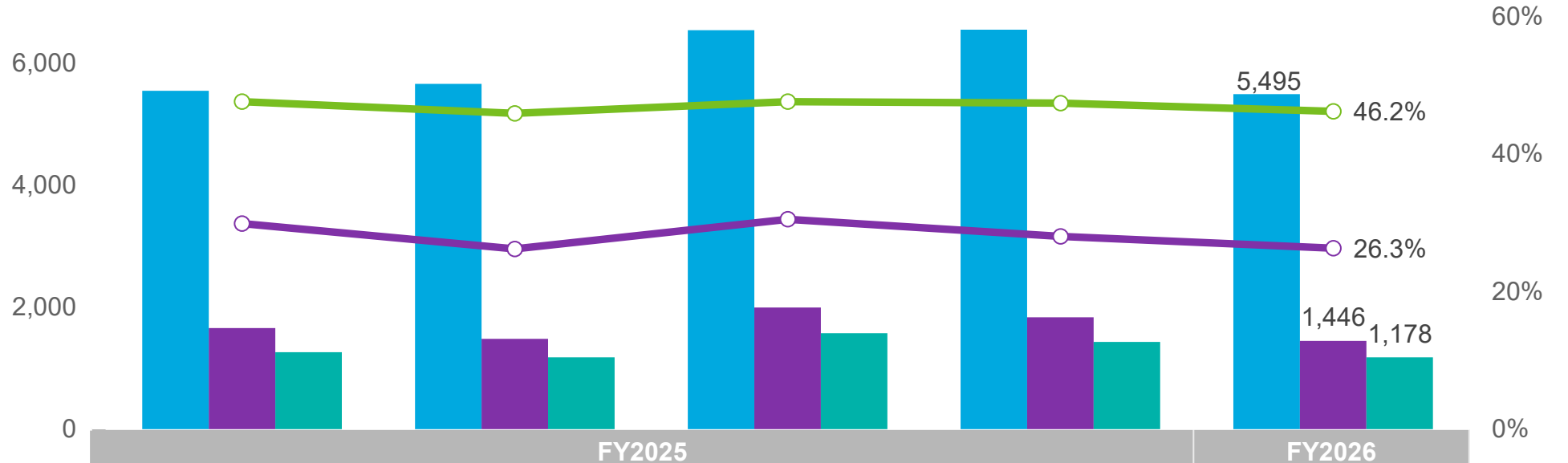
（億円）

	FY2025				FY2026	vs. FY2025 Q4	vs. FY2025 Q1
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1		
売上高	5,550	5,665	6,545	6,554	5,495	-16.1%	-1.0%
売上総利益	2,640	2,599	3,117	3,105	2,539	-18.2%	-3.8%
売上総利益率	47.6%	45.9%	47.6%	47.4%	46.2%	-1.2pts	-1.4pts
販管費	982	1,117	1,121	1,267	1,092	-13.8%	+11.2%
営業利益	1,657	1,481	1,996	1,837	1,446	-21.3%	-12.7%
営業利益率	29.9%	26.2%	30.5%	28.0%	26.3%	-1.7pts	-3.6pts
税金等調整前当期純利益	1,672	1,536	2,001	1,851	1,519	-17.9%	-9.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,261	1,177	1,572	1,429	1,178	-17.6%	-6.6%
研究開発費	534	620	618	727	621	-14.5%	+16.3%
設備投資額	239	533	502	346	528	+52.7%	+120.2%
減価償却費	132	145	160	183	171	-6.6%	+30.0%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

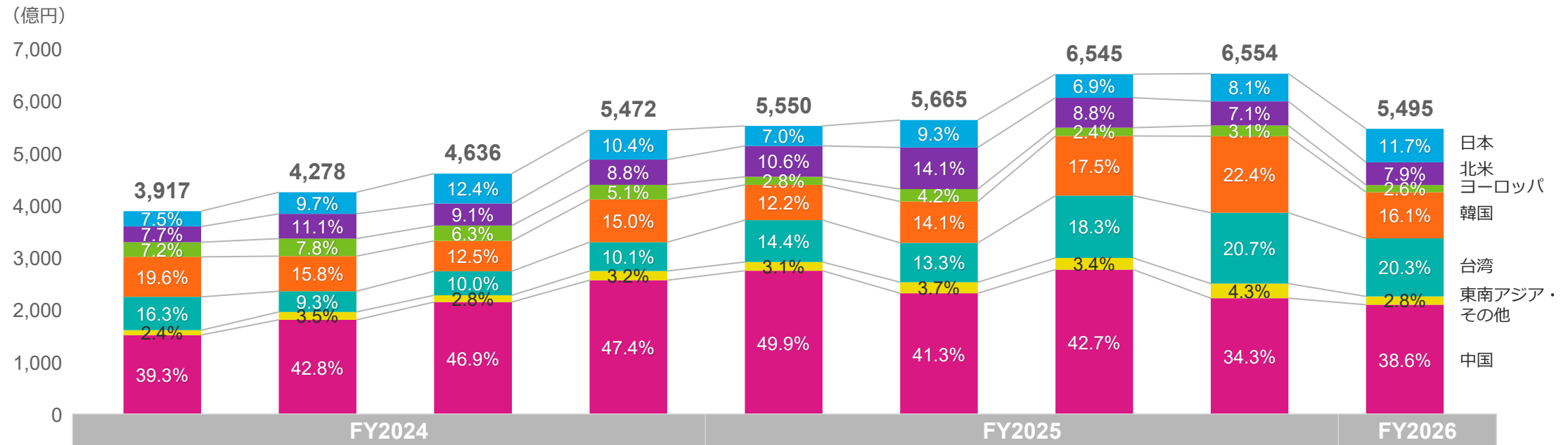
損益状況（四半期）

(億円)



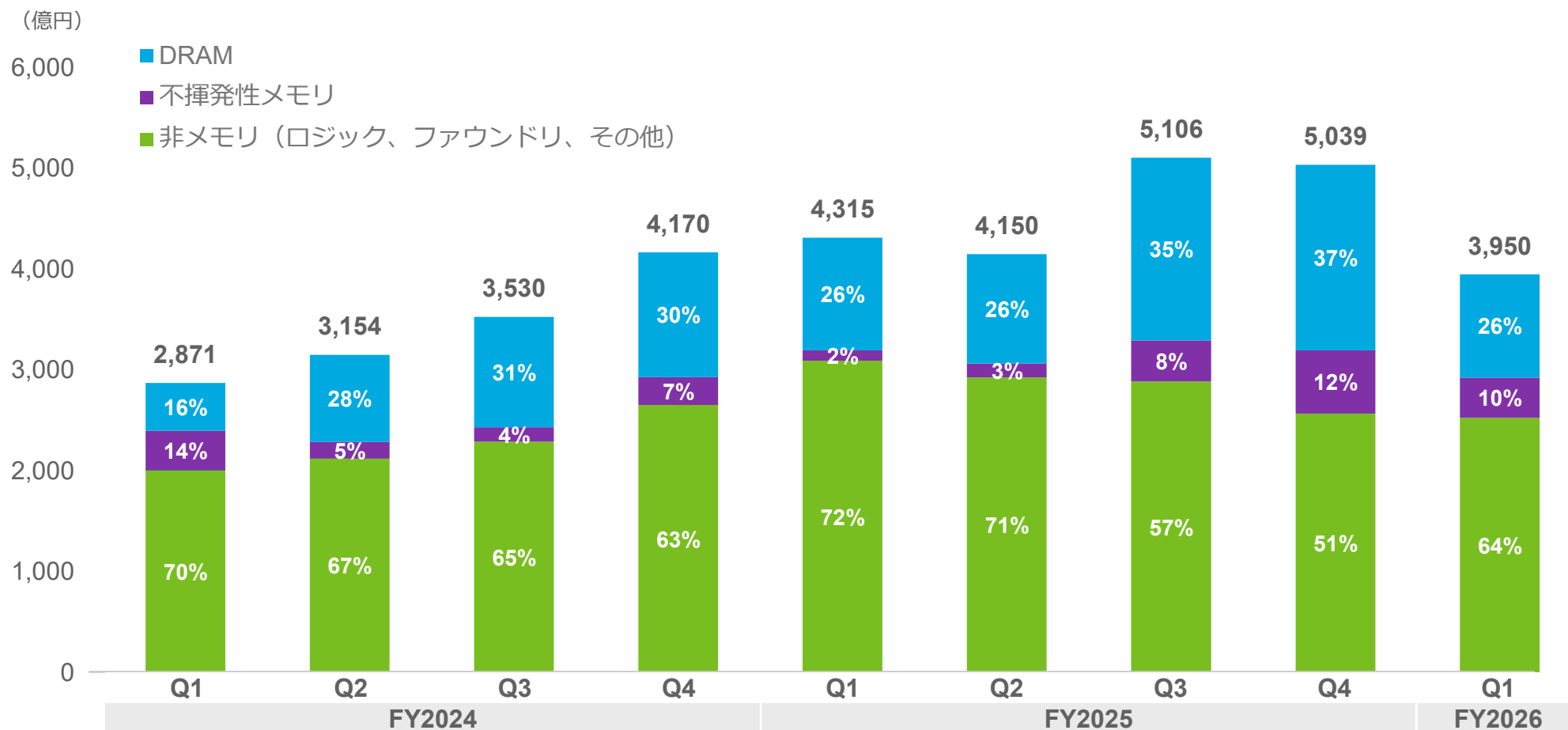
	Q1	Q2	Q3	Q4	
売上高	5,550	5,665	6,545	6,554	5,495
営業利益	1,657	1,481	1,996	1,837	1,446
親会社株主に帰属する当期純利益	1,261	1,177	1,572	1,429	1,178
売上総利益率	47.6%	45.9%	47.6%	47.4%	46.2%
営業利益率	29.9%	26.2%	30.5%	28.0%	26.3%

地域別売上高構成比（四半期）



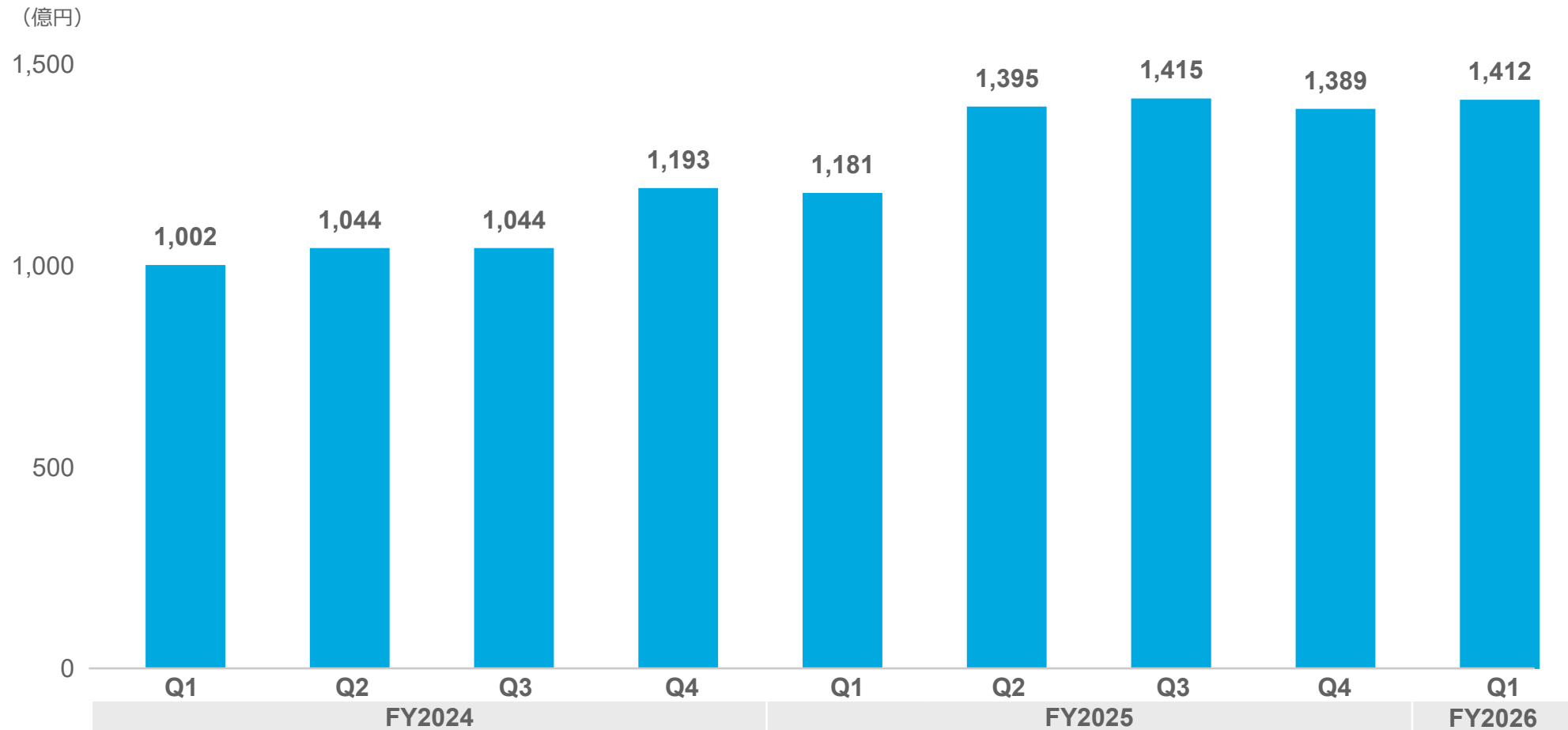
	FY2024				FY2025				FY2026
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
日本	295	412	574	567	385	526	453	534	643
北米	301	474	421	483	590	799	577	462	434
ヨーロッパ	281	335	294	281	155	238	157	203	140
韓国	767	674	582	820	678	795	1,145	1,470	883
台湾	639	399	463	552	800	753	1,193	1,358	1,115
東南アジア・その他	92	151	127	175	170	212	223	278	156
中国	1,539	1,829	2,172	2,591	2,770	2,339	2,794	2,246	2,121

SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



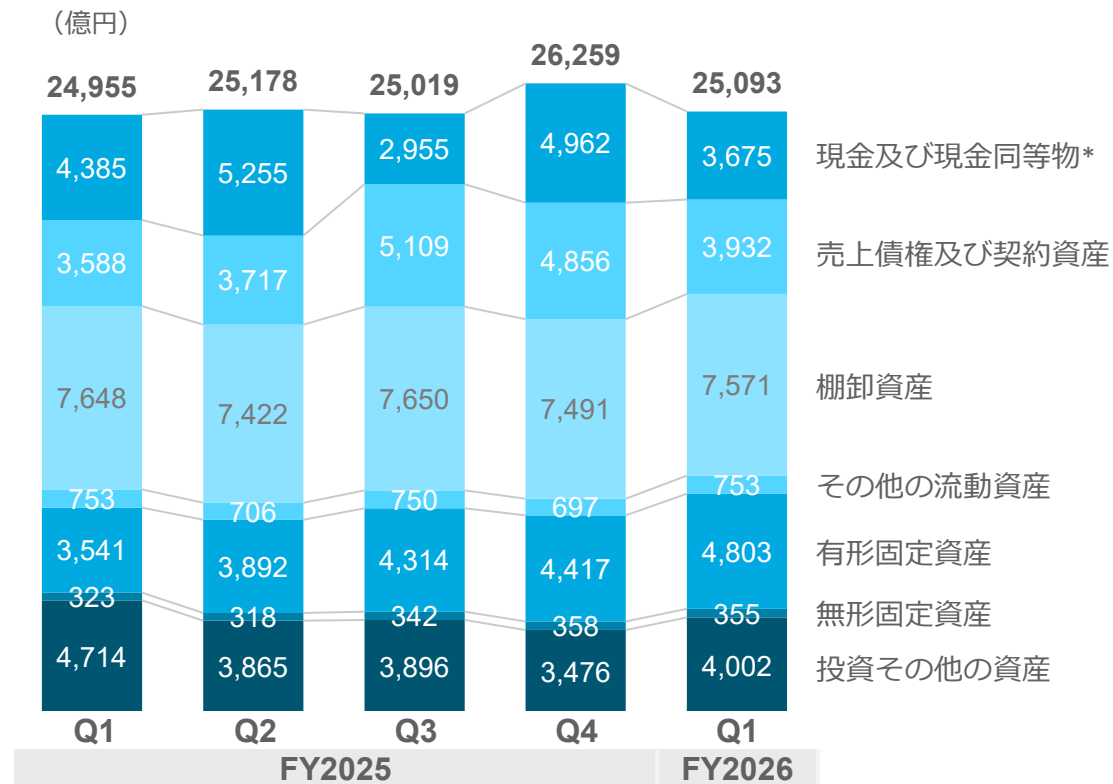
1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

フィールドソリューション売上高（四半期）

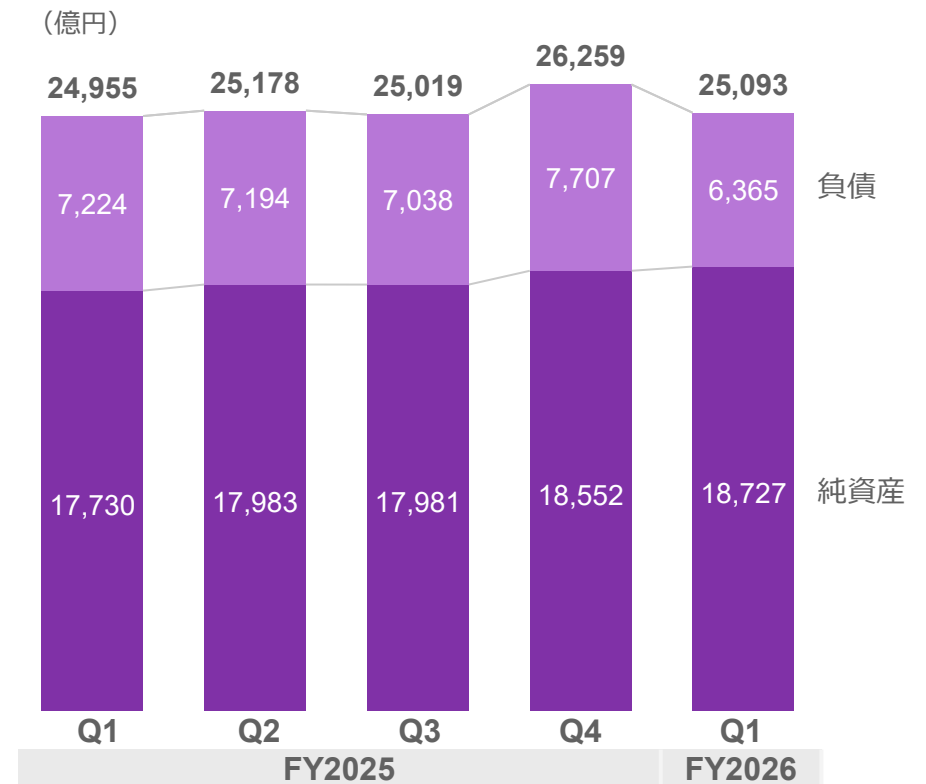


貸借対照表（四半期）

資産

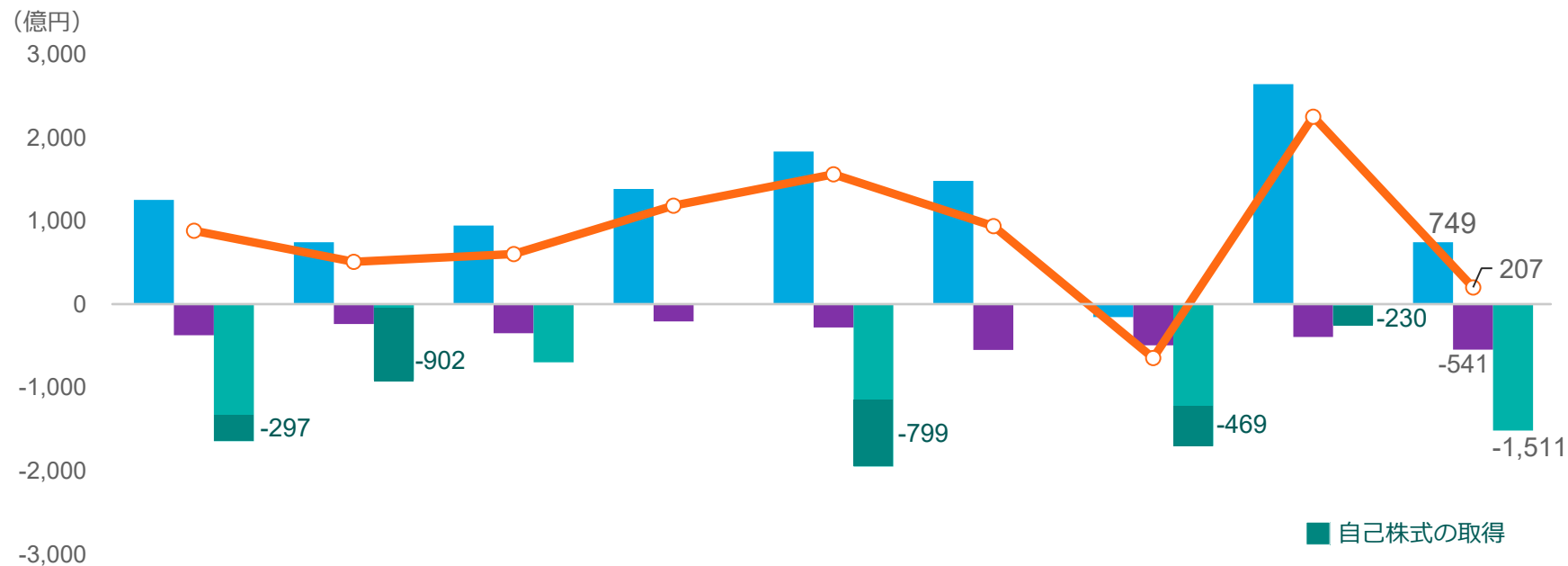


負債・純資産



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2024				FY2025				FY2026
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
■ 営業キャッシュ・フロー	1,257	748	950	1,390	1,837	1,486	-150	2,648	749
■ 投資キャッシュ・フロー ^{*1}	-368	-234	-344	-203	-273	-544	-490	-389	-541
■ 財務キャッシュ・フロー	-1,641	-908	-693	-6	-1,944	-6	-1,701	-235	-1,511
○ フリーキャッシュ・フロー ^{*2}	888	514	606	1,187	1,564	941	-641	2,258	207
手元資金残高 ^{*3}	4,010	3,626	3,524	4,725	4,385	5,255	2,955	4,962	3,675

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

2025年7月31日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



市場環境と事業進捗

■ FY2026 Q1：計画通り進捗

- 売上・利益とも、ほぼ計画どおり
 - 売上高 5,495億円、営業利益 1,446億円、営業利益率 26.3%
- POR*の獲得や、将来成長に向けた戦略製品の開発評価も順調
 - 新規 低抵抗メタル成膜装置、多くのNAND顧客において評価進捗
 - レーザーリフトオフを含む3Dインテグレーション装置、商談進行中
 - 東京エレクトロン宮城 新開発棟 竣工

■ FY2026上期業績見通し：変更なし

- 売上高 1兆1,500億円、営業利益 2,880億円、営業利益率 25.0%

■ CY2025 WFE：ほぼ想定通り

- 為替等の動向を反映し、4月想定の\$110Bから\$115Bに修正

* POR (Process of Record)：顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

市場環境と事業進捗

■ CY2026上半期（1月～6月）の動向：

顧客の歩留まり改善による生産性向上、利益を意識した需給バランスの最適化、先行投資から着実な投資への切り替えなどにより、FYベース（FY2026）のWFEはマイナス5%成長と予測を修正

- 一部先端ロジック顧客の設備投資の見直し
- 中国新興半導体メーカーによるレガシー投資の縮小
- NANDにおける、需給バランスを慎重に見た投資計画の変更
- HBM*需要は旺盛なものの、生産技術および顧客の歩留まり向上による投資計画の見直し
- DRAM DDR4からDDR5への全量切り替え投資タイミングの遅延

* HBM（High Bandwidth Memory）：高帯域幅DRAM

FY2026 業績予想

(億円)

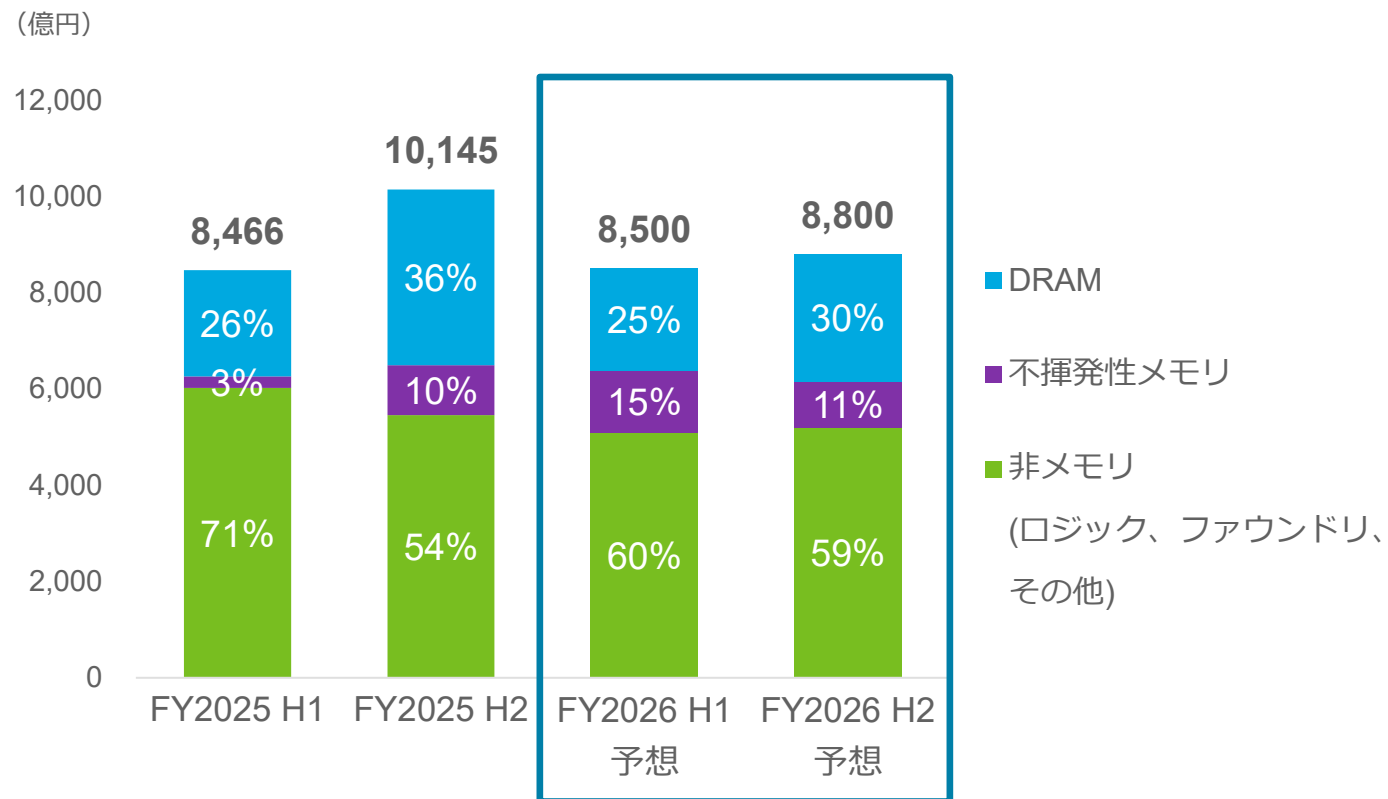
	FY2025 (実績)	FY2026 (新予想)					ご参考：FY2026 (4/30時点予想)	
		H1	H2	通期	vs FY2025	修正額*	H2	通期
売上高	24,315	11,500	12,000	23,500	-3.4%	-2,500	14,500	26,000
売上総利益 売上総利益率	11,462 47.1%	5,270 45.8%	5,390 44.9%	10,660 45.4%	-7.0% -1.7pts	-1,620 -1.8 pts	7,010 48.3%	12,280 47.2%
販管費	4,489	2,390	2,570	4,960	+10.5%	-50	2,620	5,010
研究開発費	2,500	1,400	1,550	2,950	+18.0%	-50	1,600	3,000
研究開発費以外の販管費	1,989	990	1,020	2,010	+1.0%	0	1,020	2,010
営業利益 営業利益率	6,973 28.7%	2,880 25.0%	2,820 23.5%	5,700 24.3%	-18.3% -4.4pts	-1,570 -3.7pts	4,390 30.3%	7,270 28.0%
税金等調整前当期純利益	7,061	2,930	2,860	5,790	-18.0%	-1,570	4,430	7,360
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	2,240	2,200	4,440	-18.4%	-1,220	3,420	5,660
1株当たり当期純利益（円）	1,182.40	488.93	-	969.12	-213.28	-266.39	-	1,235.51

* 2025年4月30日に発表した通期業績予想からの修正額を示しています。

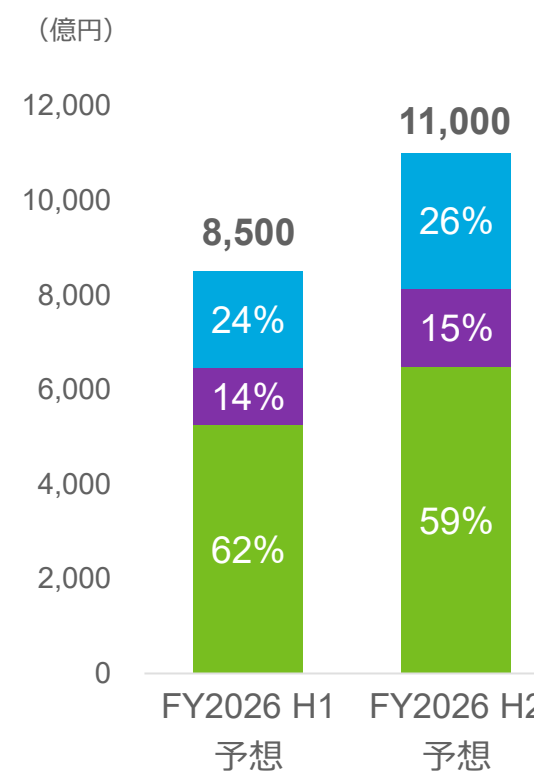
足元の顧客投資状況を踏まえ、下期の業績予想を修正

FY2026 SPE新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比



【ご参考】 4月決算発表時 予想

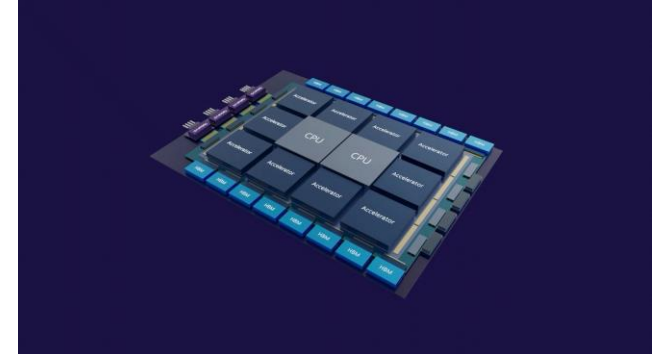


グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

最新顧客投資動向の変化により、下期予想を修正

AIサーバーに不可欠な最先端半導体

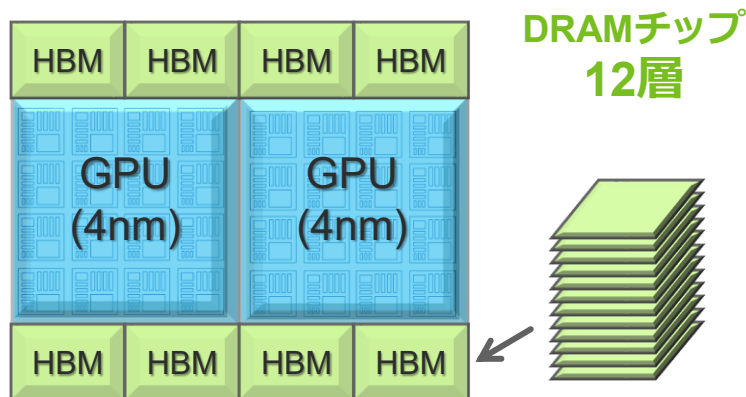
<CY2026（FY2027）の成長ドライバー>



CY2025

トランジスタ数 **約2,000億個**

メモリ容量 **288ギガ**バイト

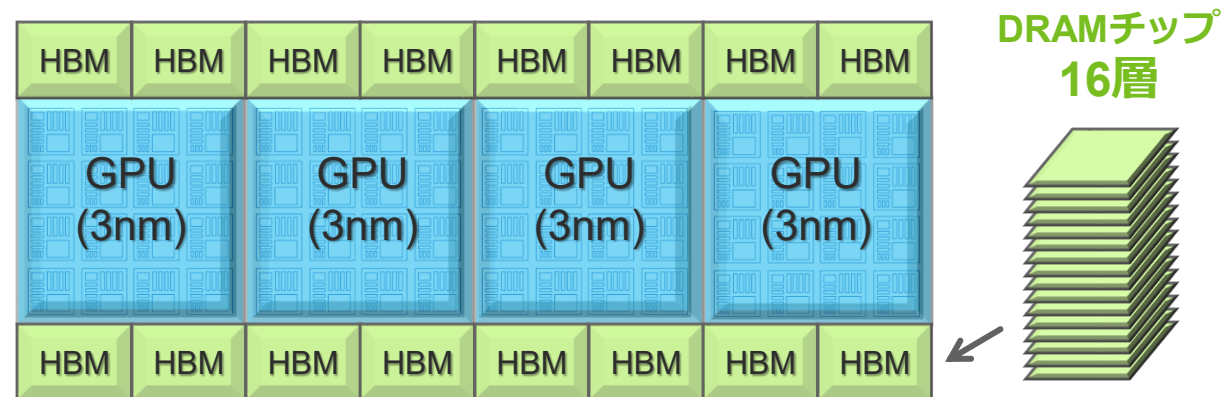


GPU : Graphic Processing Unit
HBM : High Bandwidth Memory

CY2027

トランジスタ数 **約5,000億個**

メモリ容量 **1テラ**バイト（1,024ギガバイト）



TEL estimates

この先2年でトランジスタ数は2.5倍に、メモリ容量は4倍に増加。
GPUは4nm世代×2個から3nm世代×4個に、HBMは12層から16層に技術革新が進む

FY2026 研究開発費・設備投資計画

新開発棟
エッチング装置



宮城県黒川郡
2025年4月 竣工

東北生産・物流センター
成膜装置



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

新開発棟
コータ/デベロッパ、洗浄装置、ボンディング装置



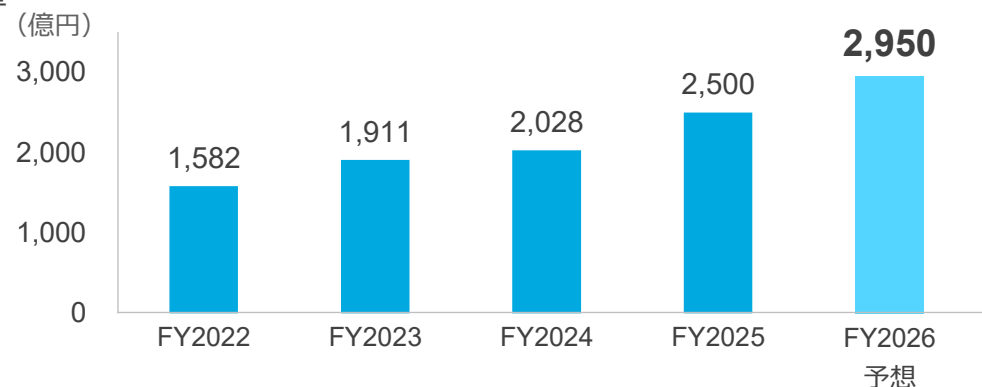
熊本県合志市
2025年秋 竣工予定

生産新棟
エッチング装置

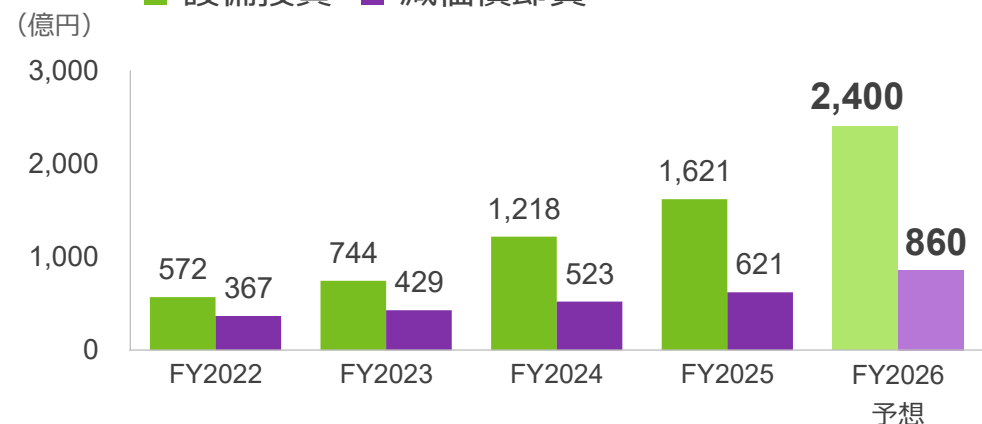


宮城県黒川郡
2027年夏 竣工予定

■ 研究開発費



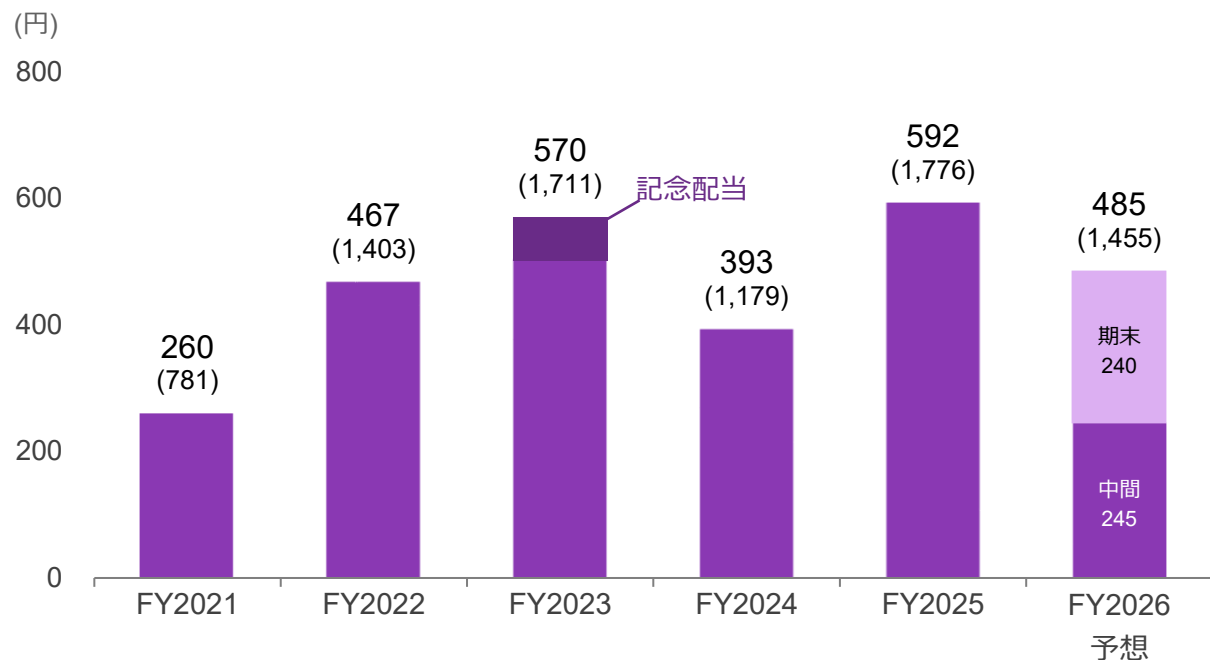
■ 設備投資 ■ 減価償却費



AIサーバー向け半導体が技術革新を牽引し、半導体の需要は拡大。
研究開発・設備投資は予定通り実施

FY2026 配当予想

1株当たり配当金



- FY2021～2023の1株当たり配当額は、FY2021の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

1株当たり通期配当は485円を予定



TOKYO ELECTRON